

# Stručný postup zpracování fotorezistu

## KOLON ACCUIMAGE řady KP 2100

**Skladování:** 5-25 °C, 30-60% relativní vlhkosti vzduchu

▼  
**Odstavný čas:** válce fotorezistu by měly mít před laminací teplotu 20-25°C

▼  
**Laminace:** 100-120°C, 0,5 – 1,5 m/min ,tlak 1,5 – 4 bary, výstupní teplota na desce 45-65°C(optimum 48°C pro FR4>1.5 mm, 60°C FR4<1 mm)

▼  
**Odstavný čas:** min. 20 min (ochladnutí), max 72hod ve tmě anebo na certifikovaném žlutém světle, max 21°C

▼  
**Osvit:** čistá měď na 10 stupni 21stupňového klínu (energie 80 mJ/cm2)

▼  
**Odstavný čas:** max .2 měsíce, max. 18°C

▼  
**Vyvolání:** min. 28 s, 0,9-1,3 % Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> nebo K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, optimální koncentrace 1% (váhových), vyvolatelnost 0,04-0,15 m2/l  
teplota 28-32°C,bod zvratu 55-75% délky vyvolávací komory, oplach 1,5-3 bary  
min.30 s při 15-30°C, pH 10,3 -11,3

▼  
**Leptání:** alkalické (do pH 9,4 v oplachovém modulu) i kyselé

▼  
**Stripování:** NaOH nebo KOH, koncentrace 2 – 4% (váhová), organické stripery (RS 111 nebo K.I.V. ST 810,ST 811), koncentrace 5 – 30%, teplota 45 – 55 °C, bod zvratu 40 – 60% délky stripovací komory, oplach 1 – 3 bar min. 20 s

Tloušťka resistu: 38 µm.

Vyrábí: KOLON Industries Inc., Kyunggi-Do, Jižní Korea

Distributor : INTERCONTI, [www.inter-conti.cz](http://www.inter-conti.cz)

Vyrobeno : Semach plošné spoje, [www.semach.cz](http://www.semach.cz)

*V případě jakýchkoli potíží nás kontaktujte.*